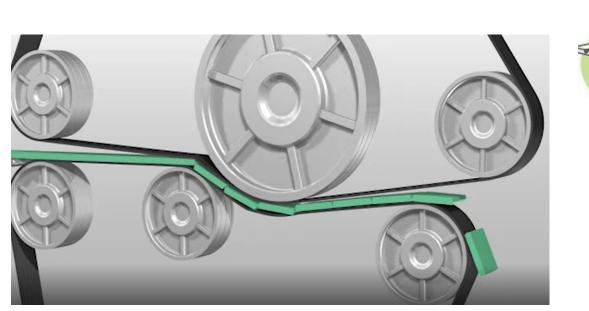
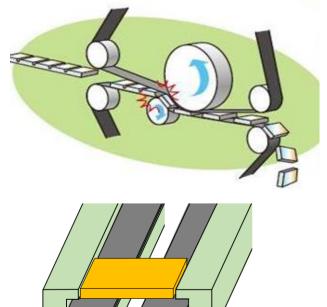


使用事例(半導体製造装置/基板分装置)







パンドー化学株式会社 BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

使用事例(半導体製造装置/基板分装置)

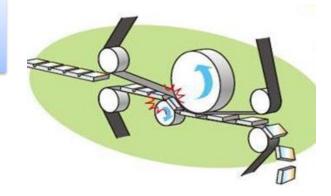
用 途:搬送用(チップ割搬送)

使用機械:半導体製造装置/基盤分割装置



ご要望

•精密搬送 •厚み精度 •耐摩耗性



当社の提案:PSベルト Aシリーズ

タイプ	厚み [mm]	引張強さ [N/10mm幅]	最小プーリ径 ^[mm]
A-1NB P/M	0.22	150	5
A-1UEW F/F	0.22	150	5
A-4UEW M/P	0.4	400	10



- ·A-1NB P/M
- ·A-1UEW F/F
- ·A-4UEW M/P



使用事例(半導体製造装置/基板搬送)

用 途: 搬送用

使用機械:半導体製造装置/基板搬送装置

ご要望

•

・耳ホツレ防止機能 厚み精度±0.05mm

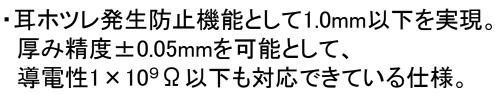
静電気防止機能 耐摩耗性



長さ0.5mm以 下の手羽

当社の提案: PSベルト TA-4UEB M/D

タイプ゜	厚み	引張強さ	最小プーリ径
	[mm]	[N/10mm幅]	^[mm]
TA-4UEB M/D	0.65	400	10



・実機6000時間相当耐久クリアし、幅4.5mmのベルト2本で 3kgfの基盤を高速搬送することが可能。

